



## 慶應義塾大学ビジネス・スクール

# 株式会社ディスコ (DISCO Corporation)

5

株式会社ディスコ (DISCO Corporation、以下ディスコという) は、東京都大田区に本社を置く半導体製造装置メーカーである。主な事業として、半導体ウェーハを切断するダイサーや研削するグラインダーなどの装置と、装置に搭載する砥石などの消耗品の開発・製造・販売を行っている。切断装置については世界シェアの約 80% を握る企業である。売上高は約 997 億円 (2011 年 3 月期)、営業利益は約 159 億円、従業員数は 1700 名を有し、東証一部に上場する企業である。

10

## ディスコの沿革

ディスコは、1937 年に広島県呉市で関家三男により創業された。当時の社名は、「第一製砥所」であった。第一製砥所では主に研磨用砥石の開発・製造・販売を手がけていた。想定していた砥石の販売先は、当時呉市に置かれていた呉海軍工廠であった。ここには、海軍の造船所が置かれており、そこで戦艦大和をはじめとする軍艦の建造や整備・メンテナンスが行われていた。これら軍艦の砲身の整備・メンテナンスには砥石が不可欠であり、第一製砥所もこの分野への参入を考えた一社であった。しかし、後発でこの分野に参入した同社は、海軍から十分な受注を得ることができなかった。そこで本社を東京に移転すると共に、研磨用の砥石から製造技術の応用が可能な切断用薄型砥石 (ブレード) への製品の転換を図ることになった。

15

20

その後、切断用薄型砥石の開発に着手した第一製砥所は、独自の製法を追究し、電力計の部品をはじめとする精密部品を切断するためのブレードを市場に次々と投入した。戦後の日本では復

25

本ケースは慶應義塾大学ビジネス・スクールが出版するものであり、複製等についての問い合わせ先は慶應義塾大学ビジネス・スクール (〒223-8526 神奈川県横浜市港北区日吉 4 丁目 1 番 1 号、電話 045-564-2444、e-mail: case@kbs.keio.ac.jp)。また、注文は <http://www.kbs.keio.ac.jp/> へ。慶應義塾大学ビジネス・スクールの許可を得ずに、いかなる部分の複製、検索システムへの取り込み、スプレッドシートでの利用、またいかなる方法 (電子的、機械的、写真複写、録音・録画、その他種類を問わない) による伝送も、これを禁ずる。

本ケースの作成にあたって、株式会社ディスコ 営業技術本部 マーケティンググループリーダー 川合章仁氏、経営支援室 広報チーム 江本俊也氏、田村和美氏および富士通セミコンダクター株式会社 開発・製造本部 LSI 実装統括部 第二技術部 担当部長 下別府祐三氏から貴重な情報をご提供いただいた。また、公益財団法人日本生産性本部 経営アカデミー 技術経営コース A グループ (2010 年度) の各メンバー (株式会社三菱化学 高原 潤氏、富士通アドバンステクノロジー株式会社 吉良秀彦氏、住友軽金属工業株式会社 佐竹誠也氏、ホーユー株式会社 菅沼壮一氏、テルモ株式会社 鈴木隆弘氏、株式会社ブリヂストン 矢川一夫氏) には、株式会社ディスコおよび富士通セミコンダクターの取材の設定および同席と、本ケース作成に必要な大変重要な知見をご提供いただいた。この場を借りてお礼申し上げる。

30

Copyright© 樋村敦司 (MBA)、余田拓郎教授 (2011 年 6 月作成)